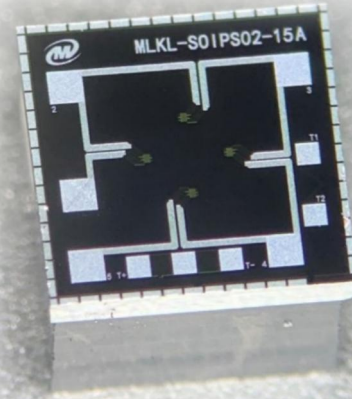


## MLKL-SOI-A 型压力传感器芯片

### 产品概述

MLKL-SOI 系列高温传感器芯片是使用耐高温 SOI 材料，基于单晶硅压阻效应，采用特种耐高温加工工艺制作的硅压阻式绝对压力传感器芯片，具有高精度、抗玷污、无 PN 结漏电、长期稳定性好、工作温度高、温度漂移小等特点。产品可工作于  $-60^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$  的温度范围。该芯片依靠公司自主研发技术，能够满足高温环境下，高精度、高可靠的压力测量需求，系列包括 10MPa、20MPa、40MPa 的绝压压力量程。



### 应用

- 航空航天
- 工业过程控制
- 医疗器械
- 气象监控
- 发动机控制

### 产品特点

- 绝压压阻式 MEMS 传感器芯片
- 大厚度芯片，隔绝应力：  
2.70 mm (L) × 2.70 mm (W) × 1.90mm (H)
- 电压源供电
- 开/闭惠斯通电桥，毫伏级输出
- 额定压力量程：10MPa 绝压
- 良好的长期稳定性和耐高温工作能力



## 主要参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
满量程输出	80	100	120	mv@5V
电桥电阻	0.8	1.0	1.2	KΩ
零点输出	-10	-	10	mV
电桥电阻温度系数	0.1	0.12	0.15	%/K
满量程温漂系数	-0.15	-0.16	-0.17	%F. S. S. /K
迟滞	-	<0.05	-	±%F. S. S.
长期稳定性	-	<0.2	-	±%F. S. S. /year
线性误差	-	<0.1	-	±%F. S. S.
工作温度	-60	-	220	°C

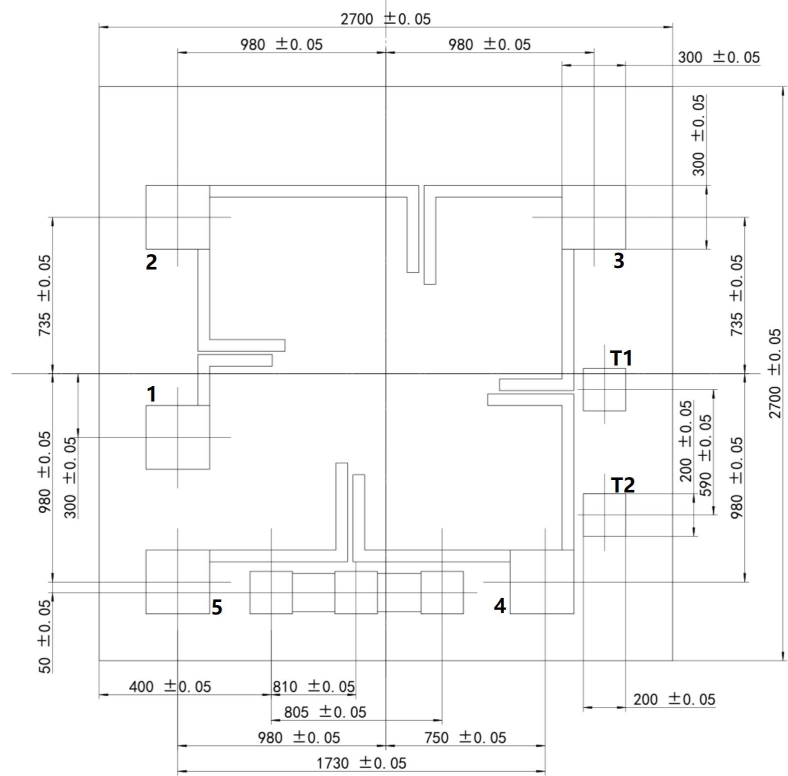
⊕：性能指标供参考，以实际订单为准。



# MLKL-SOI PRESSURE SENSOR

## 引脚定义

- 1 : GND
- 2 : VoutA
- 3 : VDD
- 4 : VoutB
- 5 : GND
- T1 — T2 : 测温电阻



MLKL-SOI-A10MPa 量程芯片芯片 (单位: 微米)

